



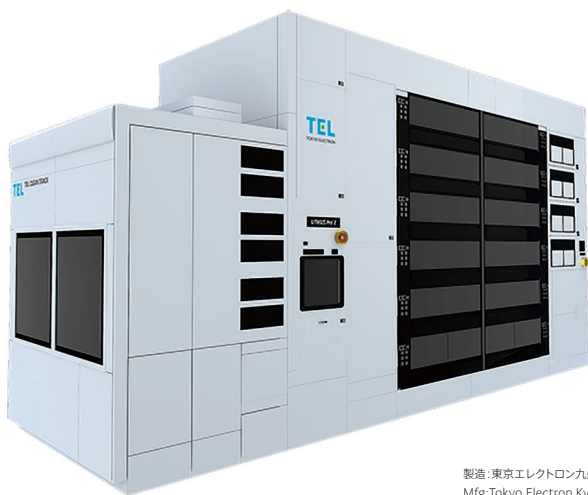
PRODUCT LINE-UP

東京エレクトロン 製品案内 2026



コータ/デベロッパ
Coater/Developer

CLEAN TRACK™ LITHIUS Pro™ Z



製造:東京エレクトロン九州
Mfg: Tokyo Electron Kyushu

Features

- Low particle wafer transfer system ■ 低発塵新搬送方式
- Improved Overall Equipment Efficiency (OEE) for litho cells ■ 最新露光機を含めたリソセルとしてのOEE向上の実現
- Reduced Cost of Chemicals (CoC) and energy usage ■ 薬液コストの大幅な削減および省エネルギー化

Applications

- All lithography processes ■ リソグラフィー全般

CLEAN TRACK™ LITHIUS Pro™ AP



製造:東京エレクトロン九州
Mfg: Tokyo Electron Kyushu

Features

- High throughput/Small footprint ■ ハイスループット/省フットプリント
- Improved OEE (Overall Equipment Efficiency) ■ OEE (Overall Equipment Efficiency) の改善
- Special wafer support (warped wafer, glass wafer, bonded wafer etc.) ■ 特殊ウェーハ対応 (反りウェーハ、ガラスウェーハ 貼り合わせウェーハ etc)

Applications

- Advanced packaging process ■ アドバンスドパッケージプロセス
- Polyimide process ■ ポリイミドプロセス
- SOG/SOD coating process ■ SOG/SOD塗布プロセス

CELLESTA™ -i



製造:東京エレクトロン九州
Mfg:Tokyo Electron Kyushu

Features

- High throughput of up to 1,000 wafers per hour ■ 高スループット(最大毎時1,000枚)
- Damage-free physical cleaning using new atomizing spray ■ 新2流体スプレーによるダメージレス物理洗浄
- Unique drying technology that controls watermarks and pattern damage ■ ウォーターマーク、パターン倒壊を抑制する独自乾燥技術
- Independent control of process environment in each chamber ■ チャンバーごとのプロセス雰囲気独立制御
- Spinner technology compatible with various process chemistries ■ 各種アプリケーション対応スピナー技術

Applications

- Pre-diffusion and pre-CVD cleaning ■ 拡散前/CVD前洗浄
- Post-etch cleaning ■ エッチング後洗浄
- Wet etch ■ ウェットエッチング
- Backside and bevel cleaning ■ 裏面・ベベル洗浄
- Post-etch polymer removal ■ 配線加工ポリマー除去

EXPEDIUS™ -i



製造:東京エレクトロン九州
Mfg:Tokyo Electron Kyushu

Features

- Transfer system with throughput of 1,000wph ■ 毎時1,000枚の搬送能力
- Short-time resist stripping ■ 短時間レジスト剥離処理槽搭載可能
- Highly selective and stable process for 3D NAND SiN etch process ■ 高選択比で安定的なプロセスを提供する3D NAND向けSiN選択エッチング
- New nozzle concept for etch uniformity Improvement (WIW, WTW) ■ 新ノズルコンセプトで槽内均一性(WIW、WTW)向上
- Equipped with a stacked dual chamber dryer (SD2) ■ SD2 (Stacked dual chamber dryer) 搭載

Applications

- Pre-diffusion and pre-CVD cleaning ■ 拡散前/CVD前洗浄
- Post-etch cleaning and resist strip ■ エッチング後洗浄/レジスト剥離
- Wet-etch (SiN etch, W recess, Poly Si etch) ■ ウェットエッチング (SiN etch、W recess、Poly Si etch)
- Rework and recycle ■ リワーク/リサイクル

プラズマエッチング装置 Plasma Etch System

Episode™ UL



製造: 東京エレクトロン宮城
Mfg: Tokyo Electron Miyagi

Features

Maximize space utilization with a flexible arrangement of up to 12 chambers

Make your manufacturing smarter with:

- Multiple sensors for tool health monitoring
- EtherCAT* for high speed process control
- AI/Machine Learning for Big Data analysis
- Auto calibration for tool matching

■ 最大12チャンバーまで搭載可能とし、スループット、稼働率、スペース効率などの高生産性最大化を実現したスマートツール

- 多数のセンサー設置による安定稼働
- EtherCAT*による高速モニタリングおよび高速制御
- 機械学習によるビッグデータ解析
- オートキャリブレーション機能による機差低減

*EtherCAT: Ethernet for Control Automation Technology (産業用オープンネットワーク)

*EtherCATは、Beckhoff Automation GmbH の登録商標です。

*EtherCAT is a registered trademark of Beckhoff Automation GmbH.

Applications

Dielectric ■ 絶縁膜

Conductor ■ シリコン

Reactive Ion Etch ■ 反応性イオンエッチング

プラズマエッチング装置

Plasma Etch System

TactrasTM



製造:東京エレクトロン宮城
Mfg:Tokyo Electron Miyagi

Features

- Support up to 6 process chambers and after treatment chambers ■ 最大6個のドライエッチチャンバー、および後処理チャンバーを選択搭載可能
- Robust design to minimize offset in machine-to-machine and chamber-to-chamber ■ 装置間、チャンバー間の機差を最小化するロバスト設計
- Particle reduction technology ■ パーティクル低減技術

Applications

- Dielectric ■ 絶縁膜
- Conductor ■ シリコン
- Reactive Ion Etch ■ 反応性イオンエッチング

ガスケミカルエッチング装置 Gas Chemical Etch System

Certas LEAGA™



製造: 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ
Mfg: Tokyo Electron Technology Solutions

Features

Higher productivity with flexible module layout concept

Selective etch of various oxide films

Good controllability of micro-loading and etch profile

■ カスタマイズ可能な
モジュール構成による生産性向上

■ 各種酸化膜に対する選択エッチング

■ 粗密パターンでのローディング低減、
エッチング形状コントロールが可能

Applications

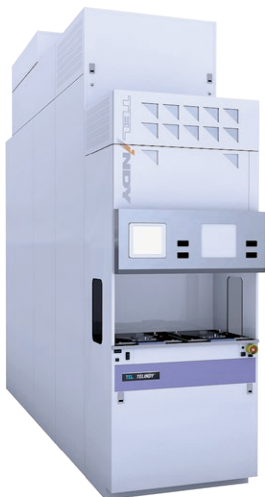
Dielectric

Chemical dry etch

■ 絶縁膜

■ ケミカルドライエッチング

TELINDY PLUS™



製造:東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ
Mfg:Tokyo Electron Technology Solutions

Features

- Batch ALD process to achieve high step coverage and high productivity ■ バッチ式ALDによりカバレッジ性能の確保と高生産性を両立
- Seed technology to achieve thin film controllability ■ シード技術によるCVD膜の薄膜制御性の向上
- High-speed robotics ■ 高速搬送メカ
- Dry cleaning technology for particle reduction ■ ドライクリーニング技術による微小パーティクル制御
- 31% reduction of energy consumption per wafer by decreasing L/L N2 flow rate and by higher throughput (SEMI S23 conversion, compared to TELINDY™) ■ L/L N2流量削減、スループット向上によりウェーハ当たりのエネルギー消費量31%削減 (SEMI S23換算、TELINDY™比)

Applications

- Oxide/Anneal/CVD/ALD ■ 成膜装置 (酸化/アニール/CVD/ALD装置)

ALD装置

Atomic Layer Deposition System

NT333™



製造:東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ
Mfg:Tokyo Electron Technology Solutions

Features

- Thickness controllability at the monolayer level through sufficient gas adsorption and oxidation
- 反応ガスの十分な吸着・酸化による原子レベルでの膜厚制御
- High quality film deposition by taking quality improvement steps into ALD cycles
- ALDサイクル内への改質ステップ組み込みによる高品質成膜の実現
- SiO₂ film deposited in low temperature regions ($\leq 400^{\circ}\text{C}$) has comparable HF etch resistance and leakage performance to thermal oxide
- 低温域(400度以下)において熱酸化膜同等の耐フッ酸性、リーク特性の実現
- Enabling excellent film property uniformity required for high aspect ratio structures on 3D NAND devices at high temperatures (760°C)
- 高温域(760度成膜)において3D NANDに求められる高アスペクト内の膜質均一性を達成

Applications

- Various and dielectric films Thermal and plasma configuration
- 高品質ALD Film プラズマ/サーマル

Episode™ 1



製造:東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ
Mfg:Tokyo Electron Technology Solutions

Features

- Support continuous execution of multiple processes by up to 8 process modules ■ 最大8つのプロセスモジュールにより連続プロセスが可能
- Reduced contact resistance in advanced logic devices by combining OPTCURE™ and ORTAS™ process modules ■ OPTCURE™とORTAS™のプロセスモジュールの組み合わせでコンタクト低抵抗化実現
- Enhanced data collection and edge data processing systems improve equipment availability and engineering efficiency ■ より強化されたデータ収集とエッジ情報処理機能により装置稼働率とエンジニアの作業効率改善を支援

Applications

- Logic contact ■ ロジックコンタクト工程

Episode™ 2 DMR



製造:東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ
Mfg:Tokyo Electron Technology Solutions

Features

- High throughput and minimal footprint by simultaneously transferring two wafers ■ ウェーハ2枚を同時に搬送することにより省フットプリントでの高い生産性を実現
- DMR (Duo Matched Reactor) concept enables simultaneous deposition of two wafers ■ DMR (Duo Matched Reactor) コンセプトによりウェーハ2枚を同時に成膜可能
- Succeeding the Triase+™ EX-II™ series, also offers coping with future devices and higher aspect ratios ■ Triase+™ EX-II™シリーズの後継製品としてさらに将来のデバイスやより高いアスペクト比に対応
- Enhanced data collection and edge data processing systems improve equipment availability and engineering efficiency ■ より強化されたデータ収集とエッジ情報処理機能により装置稼働率とエンジニアの作業効率改善を支援

Applications

- Capacitor electrode ■ キャパシタ電極
- Word line TiN ■ ワードラインTiN
- Barrier metal ■ バリアメタル

LEXIA™-EX



製造:東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ
Mfg:Tokyo Electron Technology Solutions

Features

- Scalable platform concept inherited from EXIM™ ■ 拡張性のあるプラットフォーム
- Footprint reduction ■ 省フットプリント
- High throughput ■ 高生産性
- Ultra high vacuum design ■ 超高真空モジュール
- Excellent uniformity ■ 優れた膜均一性
- Best in class CoC and CoO ■ 最高クラスのCoC・CoO

Applications

- Multilayer ■ 多層膜
- Hardmask ■ ハードマスク
- Logic functional film ■ ロジック向け機能膜

PrexaTM



製造:東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ
Mfg:Tokyo Electron Technology Solutions

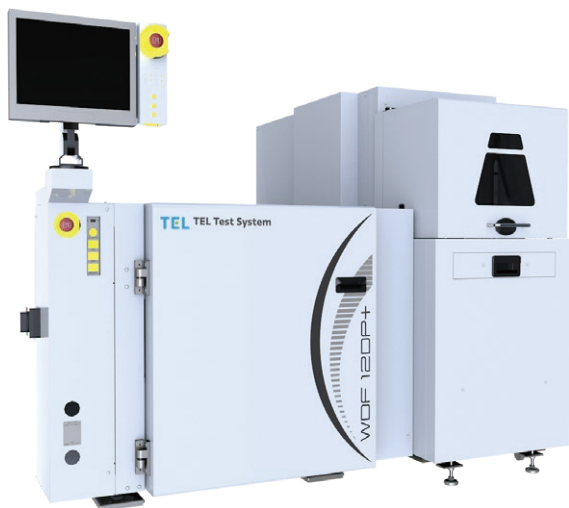
Features

- | | |
|---|---|
| Automation of operations | ■ 自動化オペレーション |
| High accuracy contact | ■ 高精度コンタクト |
| High speed inspection | ■ 高速インスペクション |
| New software structure | ■ 新オペレーションソフトウェアシステム |
| Advanced safety functions
for probe card and wafer | ■ プローブカード、ウェーハ安全機構 |
| UTCS (Uniformize Temperature
Control System) | ■ UTCS (Uniformize Temperature
Control System) |

Applications

- | | |
|--|--------------------------------|
| High heat generating device
(HPC, GPU, Memory etc.) | ■ 高発熱デバイス
(HPC、GPU、Memory等) |
| Small die and fine pitch probing | ■ 狭ピッチ/小パッド、プローピング |
| High pin count and high multi-site
SoC and memory | ■ 多ピン/多マルチ測定 |
| Full wafer testing | ■ フルウェーハテスト |
| Low noise parametric probing | ■ 低ノイズ・パラメトリック測定 |

WDF™ 12DP+



製造:東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ
Mfg:Tokyo Electron Technology Solutions

Features

- Fully automatic dicing frame and standard wafer handling ■ ダイシングフレームおよび標準ウェーハ全自動搬送対応
- Change over kit to easily switch between 300mm and 200mm ■ COK/チェンジオーバーキットでの容易な300/200mm切り替え
- N-Shot alignment for high accuracy, parallelism probing for diced wafer ■ N-Shot アライメントによるダイシング後ウェーハへ高精度・多マルチプロービング
- Improved system cleanliness and ESD* ■ 装置クリーン度、静電気対策改善
- TEL standard prober application software ■ TEL標準ウェーハプローバアプリケーションソフトウェア対応

Applications

- Post dicing test for KGD*, RMA* ■ ダイシング後テストによるKGD*保証、およびRMA*
- Advanced package test capability (WLP, FOWLP, Panel level package) ■ 先端パッケージテスト (WLP、FOWLP、Panel level package)
- Test for thin wafer, multiple PCB, strip frames on dicing frames ■ ダイシングシートに貼り付けられた薄ウェーハ、複数のPCB、ストリップフレームテスト

マルチセルテストシステム Multi-Cell Test System

Cellcia™



製造:東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ
Mfg:Tokyo Electron Technology Solutions

Features

- Asynchronous and simultaneous test in each cell ■ 完全に独立したセル構造による複数ウェーハの同時テスト
- Ultra-compact footprint by multi-layer system structure ■ 多段積み構造によるフットプリントの大幅削減
- TAT reduction by simultaneous test in multiple cells ■ 複数ウェーハ同時処理によりTAT (Turn Around Time) 大幅短縮
- Highly reliable front-end equipment wafer robot technology ■ 前工程プラットフォーム技術に応用した高信頼性搬送ロボット

Applications

- 300mm memory device ■ 300mm メモリデバイス
- Full wafer contact ■ フルウェーハー括コンタクト

ウェーハボンディング/デボンディング装置 Wafer Bonding/Debonding System

Synapse™ V / Synapse™ Z Plus



製造:東京エレクトロン九州
Mfg: Tokyo Electron Kyushu

Features

- Designed for high volume manufacturing ■ 本格量産用装置デザイン
- Realizes the entire temporary bonding process ■ 接合プロセスに要求される材料塗布からウェーハ接合までの一貫プロセスの実現
- Achieves debonding and handling of wafer with 35um or greater thickness ■ 剥離プロセスでは35um厚までのウェーハ剥離・洗浄・搬送を実現
- Establishes room temperature debonding process ■ 常温デボンディング技術の確立による高いプロセスマージンの実現

Applications

- Temporary bonding and debonding for TSV manufacturing ■ TSV用ウェーハ仮接合/剥離
- Wafer permanent bonding ■ 接着剤によるウェーハ永久接合

ウェーハボンディング装置 Wafer Bonding System

Synapse™ Si



製造:東京エレクトロン九州
Mfg:Tokyo Electron Kyushu

Features

- Designed for high volume manufacturing ■ 本格量産用装置デザイン
- High availability for production ■ 高い稼働率を実現
- Excellent alignment accuracy ■ 高いアライメント精度を実現
- Realized high volume manufacturing with Cu hybrid wafer bonding technology ■ Cu ハイブリッドウェーハ接合の量産化を実現

Applications

- Any application requires fusion bonding ■ フュージョンウェーハ接合
- Any application requires Cu hybrid wafer bonding device ■ Cu ハイブリッドウェーハ接合を利用するあらゆる製品に対応

レーザエッジトリミング装置 Laser Edge Trimming System

Ulucus™ L



製造:東京エレクトロン九州
Mfg:Tokyo Electron Kyushu

Features

- Designed for high volume manufacturing ■ 本格量産用装置デザイン
- Excellent trimming accuracy ■ 高いトリミング精度を実現
- Latest platform utilizing clean technology from the front-end process, with the integration of laser technology ■ 前工程レベルのクリーン技術を適用した最新プラットフォームとレーザ技術を融合
- Ensured reduction in DIW* consumption, dust emissions, and waste water discharges ■ 純水使用量、粉塵排出量、排水量の削減

* Deionized water

Applications

- 300mm wafer to wafer fusion bonding device ■ 300mmフュージョンウェーハ接合を利用する製品
- 300mm wafer to wafer Cu hybrid bonding device ■ 300mm Cu ハイブリッドウェーハ接合を利用する製品

先端レーザ剥離装置 Extreme Laser Lift Off System

Ulucus™ LX



製造: 東京エレクトロン九州
Mfg: Tokyo Electron Kyushu

Features

- Designed for high volume manufacturing ■ 本格量産用装置デザイン
- Latest platform utilizing clean technology from the front-end process, with the integration of laser technology ■ 前工程レベルのクリーン技術を適用した最新プラットフォームとレーザ技術を融合
- Realize separation of top silicon substrate from Fusion/Cu hybrid bonded silicon substrate using laser technology ■ レーザ技術を用いた永久接合ウェーハの基板分離を実現
- Technology for reducing environmental impact by replacing existing thinning processes after Fusion/Cu hybrid bonding ■ ウェーハ永久接合後の既存薄化工程を置き換える環境負荷低減技術

Applications

- 300mm Wafer to Wafer Fusion/Cu hybrid bonding device ■ 300mm Cu ハイブリッドウェーハ接合および300mmフュージョンウェーハ接合を採用するデバイス
- Die to wafer Fusion/Cu hybrid bonding device ■ Cu ハイブリッド Die to wafer接合およびフュージョン Die to wafer接合を採用するデバイス

ウェーハ薄化装置 Wafer Thinning System

Ulucus™ G



製造:東京エレクトロン九州
Mfg:Tokyo Electron Kyushu

Features

- Wafer thinning system for 300mm wafer fabrication
- Integrating the advanced grinding technology into the latest platform of front-end's super clean technology
- Single-wafer processing units allow control over the quality of each wafer
- High-quality processing of both sides of wafers
- 300mmウェーハ製造プロセス向けウェーハ薄化装置
- 前工程レベルのスーパークリーン技術を適用した最新プラットフォームと研削加工ユニットを融合
- 枚葉加工によりウェーハごとの品質コントロールが可能
- ウェーハの両面加工を高品質で実現

Applications

- 300mm wafer fabrication
- 300mmウェーハ製造

ガスクラスタービーム装置

Gas Cluster Beam System/Pattern shaping/Trim

Acrevia™



Mfg: TEL Manufacturing and Engineering of America Inc.

Features

- Proven Gas Cluster Beam (GCB) technology for low damage etching ■ 低ダメージでエッチング可能なガスクラスタービーム技術
- Wafer scanning system with variable tilt to etch feature pattern-sidewalls ■ 傾斜機能付きウェーハスキャンシステムによりパターン側壁をエッチング可能
- Location Specific Processing (LSP) algorithm to improve within wafer uniformity ■ LSP (Location Specific Processing) アルゴリズムにより、均一性改善
- Multiple chemistries for organic and inorganic film etching ■ 対象の有機膜、無機膜に合わせたガス対応可能

Applications

- Dimension Modification ■ EUV含む対象パターンの形状補正
- WIW Uniformity Control ■ ウェーハ面内均一性制御
- Line Edge Roughness (LER) / Line Width Roughness (LWR) improvement ■ LER (ラインエッジラフネス) / LWR (ライン幅ラフネス) の改善

バッチスプレー式洗浄装置 Batch Spray Cleaning System

ZETA™ +

Features

- 省フットプリントで全自動搬送
Compact footprint with full automation
- 200/300mm対応 (full auto),
100/150/200mm対応
(semi auto)
Available for 200/300mm
(full auto), 100/150/200mm
(semi auto)
- 最大8種類の薬液、
内1種類はリサイクル可
Up to 8 point of use chemicals
and 1 recirculated chemistry
- 高温蒸気SPM処理ViPR™プロセスによりウェーハ上 ~220℃で処理可能
High temperature SPM ViPR™ process enables processing at ~220℃ on wafer



Mfg: TEL Manufacturing and Engineering of America

Apps

- FEOLウェット処理、インプラ後のレジスト除去、サリサイド除去
FEOL wet steps, implanted photoresist strips and metal silicide strips
- 水性BEOLウェット処理
Aqueous BEOL wet steps
- Si/SiC/AlTiC/Glass/Sapphire

極低温エアロゾル枚葉洗浄装置 Single Wafer CryoKinetic Cleaning System

ANTARES™

Features

- 微小欠陥異物の高除去性能
High fall-on particle removal efficiency
- 純水、薬液を使用しない固体エアロゾル洗浄
Uses no water or wet chemicals
- 洗浄時のメタルへのエッチおよび腐食防止
Will not etch or corrode metals
- 洗浄時の下地膜ダメージ防止
Will not etch or alter film properties
- 純水洗浄で困難な疎水膜での洗浄可能
Ideal for hydrophobic films



Mfg: TEL Manufacturing and Engineering of America

Apps

- DCプローブ後洗浄
Post DC probe
- FEOL High-k膜成膜後洗浄
Post FEOL High-k
- BEOL 絶縁膜、Low-k膜成膜後洗浄
Post BEOL dielectric, Low-k
- BEOL CMP後洗浄
Post BEOL CMP
- BEOLエッチング後パーティクル除去洗浄
Post BEOL RIE

CLEAN TRACK™ ACT™ 8Z

Features

- ACT™8からのプロセストレース100%
100% process transfer compatible from ACT™8
- 300mmプロセス装置のバックエンジニアリング
(新レジスト供給システム、超音波流量計採用)
Back-engineering of 300mm process technology
(New resist supply system, Ultrasonic flow meter)
- メンテナンス性能改善
(搬送アーム、自動データバックアップ 等)
Improved maintenance performance
(Handling arm, Automatic data backup etc)



製造:東京エレクトロン九州
Mfg:Tokyo Electron Kyushu

Apps

- 対応可能プロセス; i-line, KrF, ArF, SOG/SOD, PI
Available process; i-line, KrF, ArF, SOG/SOD, PI
- SiC, GaNを筆頭にした化合物半導体に対応可能
Available substrate / size: Si, SiC, GaN, Glass, InP etc. / 50~200mm

スクラバー洗浄装置 Scrubber System

NS300+ 200mm Conversion

Features

- 4~8チャンパー選択式による高生産性
High productivity with function of SiC thin Wafer
- 進化したスクラバープロセステクノロジー
Advanced scrubber process technology
- システム・プロセスログ管理機能
Machine and process data management system



製造:東京エレクトロン九州
Mfg:Tokyo Electron Kyushu

Apps

- ウェーハ表面・裏面洗浄/ベベル処理機能
Front-Backside cleaning/Bevel processing function
- 150/200mmのウェーハサイズに対応
Available for 150 and 200 mm wafer
- SMIF Pod/OHT 対応
SMIF pod applicable load ports/OHT applicable
- 多様化するウェーハ素材・仕様に対応
Supports a wide variety and spec of wafer materials
- ポストCMPライトケミカル洗浄
Post CMP cleaning with light chemical
- SiC薄型ウェーハ対応可能な高搬送機能
High transport function of SiC thin wafer

ガスクラスタービーム装置

Gas Cluster Beam System/Corrective Etch/Trim

UltraTrimmer Plus™

Features

- 高い精度で狙う厚さと周波数のウェーハプロファイルを達成
Reach targeted thickness and frequency wafer profile with high fidelity
- GCBによる表面の超平坦化機能
Super smooth surface flattening by GCB
- 極薄表面改質機能(酸化・窒化)
Ultra-thin surface modification function
- 膜厚または周波数データに基づくビーム照射制御
Beam irradiation control based on thickness and frequency data
- 理想的な室温プロセス処理
Ideal room temperature process
- 100、150および200mmウェーハのうち2種類を段取り替えなしで対応可能
Enabling two of 100, 150 and 200mm wafer size handling without mechanical change



Mfg: TEL Manufacturing and Engineering of America Inc.

Apps

- RFフィルター (SAW、BAWおよびFBAR) の膜厚・周波数トリミング
RF Filters (SAW, BAW and FBAR) thickness and frequency trimming
- MEMS、フォトマスクの表面平坦化
Surface flattening on MEMS device and photo mask

縦型拡散/LP-CVD/ALD装置

Vertical Diffusion/LP-CVD/ALD Furnace System

ALPHA-8SE™ i

Features

- 長期サポートを見据えパーツ/ユニット/コンポーネントを刷新
Renewed parts, units, and components for life extension
- ALDプロセスに対応: HfO_2 , Al_2O_3 , SiO_2 , AlN , TiO_2 など
ALD process capability: HfO_2 , Al_2O_3 , SiO_2 , AlN , TiO_2 and so on
- 装置管理に最適な先進のモニタリング機能
Advanced monitoring function for remote tool management



Apps

- Diffusion, LP-CVD, and ALD
- 150/200mmのウェーハサイズに対応
Available for 150 and 200mm wafer

製造: 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ
Mfg: Tokyo Electron Technology Solutions

プラズマエッチング装置 Plasma Etch System

UNITY™ Me+

Features

- UNITY™ Meのプロセスチャンバーの設計を変えずにメインコントローラー/搬送ロボットをアップデート
Update the main controller and transfer robot without changing the design of the UNITY™ Me process chambers
- UNITY™ Me+とUNITY™ Me間のレシピ互換性を実現
Realize the process recipe compatibility between UNITY™ Me+ and UNITY™ Me
- UNITY™ II eからのプロセストレースにも最適
Process trace from UNITY™ II e is also possible

Apps

- エッチング膜種: 絶縁膜、SiC/Si
Etch layer: Dielectric, SiC/Si
- 100, 150, 200mm ウェーハ対応
100, 150, 200mm wafer applicable



製造: 東京エレクトロン宮城
Mfg: Tokyo Electron Miyagi

リモート接続による装置サポートサービス TELeMetrics™ Remote/Support Service

TELeMetrics™

Features

- 装置データへのリモート接続を基盤とするサービス
Services based on remote access to equipment data
- 装置稼動やアラームを監視、早期の原因解析と是正対応
Monitor equipment status and alarms, quickly analyze causes and take corrective action
- 装置データを多角的に分析、課題に合わせたソリューションの提供
Multifaceted analysis of equipment data and provision of solutions tailored to the issues
- 専用ネットワークによるセキュアな通信
Secure communication via a dedicated network

Apps

- リモートトラブルシューティング
Remote Troubleshooting
- アラーム診断
Alarm Diagnosis
- 生産ロスの解析
Production loss analysis
- 機差マッチング
Machine difference matching
- 装置状態診断
Equipment status diagnosis



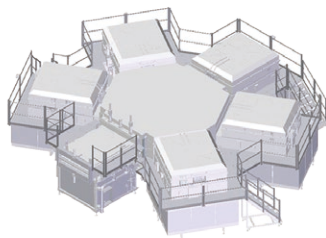
FPD エッチング/アッシング装置

FPD Etch/Ash System

BetelexTM

Features

- マルチチャンバーシステムを採用 (最大5基搭載可能)
Multi-chamber system
5 chamber maximum
- 搭載可能ユニット:
PICPTM, ECCP
Mountable units:
PICPTM, ECCP
- 対応基板サイズ:
G6, G6Half, G8, G8Half
Substrate size:
G6, G6Half, G8, G8Half



製造: 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ
Mfg: Tokyo Electron Technology Solutions

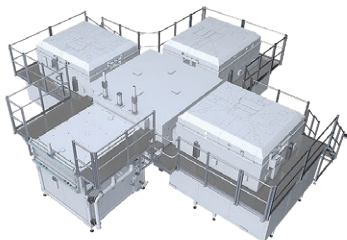
Apps

- シリコン膜エッチング
Silicon layer etch
- 絶縁膜エッチング
Insulating layer etch
- メタル膜エッチング
Metal layer etch
- アッシング
Photoresist ash

ImpressioTM

Features

- マルチチャンバーシステムを採用 (最大3基搭載可能)
Multi-chamber system
3 chamber maximum
- 搭載可能ユニット:
PICPTM, ECCP
Mountable units: PICPTM, ECCP
- 対応基板サイズ:
G8, G8Half, G10.5
Substrate size: G8, G8Half, G10.5



製造: 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ
Mfg: Tokyo Electron Technology Solutions

Apps

- シリコン膜エッチング
Silicon layer etch
- 絶縁膜エッチング
Insulating layer etch
- メタル膜エッチング
Metal layer etch
- アッシング
Photoresist ash

TEL PRODUCT LINE-UP

Japanese

www.tel.co.jp/product/

English

www.tel.com/product/



CLEAN TRACK, LITHIUS Pro, CELLESTA, EXPEDIUS, Episode, Tactras, Certas LEAGA, TELINDY PLUS, NT333, LEXIA, OPTCURE, ORTAS, Triase+, EX-II, Prexa, WDF, Cellcia, Synapse, Ulucus, ZETA, ViPR, ANTARES, CLEAN TRACK ACT, ACT, Acrevia, UltraTrimmer Plus, ALPHA-8SE, UNITY, TEL e Metrics, Betelex, PICP, Impressioは、東京エレクトロングループの日本およびその他の国における登録商標または商標です。

CLEAN TRACK, LITHIUS Pro, CELLESTA, Episode, EXPEDIUS, Tactras, Certas LEAGA, TELINDY PLUS, NT333, LEXIA, OPTCURE, ORTAS, Triase+, EX-II, Prexa, WDF, Cellcia, Synapse, Ulucus, ZETA, ViPR, ANTARES, CLEAN TRACK ACT, ACT, Acrevia, UltraTrimmer Plus, ALPHA-8SE, UNITY, TEL e Metrics, Betelex, PICP, Impressio are registered trademarks of Tokyo Electron Group in Japan and/or other countries.